

Aufgabe

Kontaktierung von elektrischen Anschlüssen mittels dünner oder dicker Bonddrähte

Technische Daten

Allgemein:

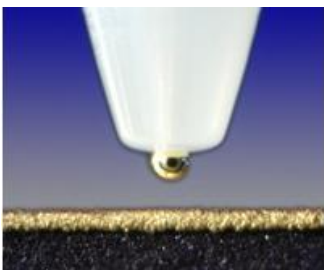
- Halbautomatische Ultraschall-Bondgeräte mit motorisierter y- und z-Achse und Bedienung über ein 6,5" Touchdisplay
- Ball- und Wedge-Bonden möglich

Eigenschaften	Dünndrahtbonder	Dickdrahtbonder
Drahtdicke	17 bis 75 µm	100 bis 500 µm
Ultraschalleistung	10 W	20 W
Bondzeit	0 bis 10 s	0 bis 10 s
Bondkraft	150 cN	1800 cN

Funktionsweise

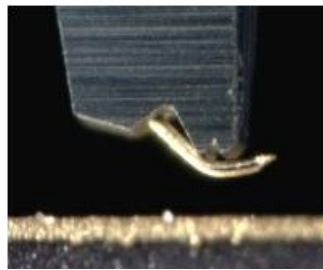
Ball-Bonden

- Draht in Kapillare
- EFO (Electronic Flame EFO) formt den Ball



Wedge-Bonden

- Draht wird über Wedge geführt



- Einstellung der Bondparameter, sowie Bond-Länge und Höhe
- Bondverbindung durch Ultraschallschweißung
- Nach dem zweiten Bond wird der Draht über eine Schneidvorrichtung abgeschnitten